

【公報種別】 特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】 第 7 部門第 2 区分
【発行日】 平成 19 年 3 月 15 日 (2007.3.15)

【公開番号】 特開 2006-80316 (P2006-80316A)
【公開日】 平成 18 年 3 月 23 日 (2006.3.23)
【年通号数】 公開・登録公報 2006-012
【出願番号】 特願 2004-263097 (P2004-263097)
【国際特許分類】

H 0 1 L 33/00 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 33/00 N

【手続補正書】
【提出日】 平成 19 年 1 月 26 日 (2007.1.26)
【手続補正 1】

【補正対象書類名】 特許請求の範囲
【補正対象項目名】 請求項 1
【補正方法】 変更
【補正の内容】
【請求項 1】

フリップ実装される固体素子と、
前記固体素子の実装面を素子実装面に対して略同一面化するようにマウントして電力の受供給を行う電力受供給部と、
前記電力受供給部と同等の熱膨張率を有して前記固体素子を封止し前記固体素子と前記電力受供給部との間に回り込まない無機封止材料からなる無機封止部とを有することを特徴とする固体素子デバイス。

【手続補正 2】
【補正対象書類名】 明細書
【補正対象項目名】 0 0 1 0
【補正方法】 変更
【補正の内容】
【0 0 1 0】

本発明は、上記目的を達成するため、フリップ実装される固体素子と、前記固体素子の実装面を素子実装面に対して略同一面化するようにマウントして電力の受供給を行う電力受供給部と、前記電力受供給部と同等の熱膨張率を有して前記固体素子を封止し前記固体素子と前記電力受供給部との間に回り込まない無機封止材料からなる無機封止部とを有することを特徴とする固体素子デバイスを提供する。